

中国国际金融股份有限公司

关于合肥晶合集成电路股份有限公司

终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定，对晶合集成终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年5月9日出具的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）501,533,789股。公司每股发行价格19.86元，募集资金总额为9,960,461,049.54元，扣除发行费用236,944,589.63元后，募集资金净额为9,723,516,459.91元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月26日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2023年5月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金额	截至 2024 年 11 月 30 日累计投入金额 (实际支付口径)
1	合肥晶集成电路先进工艺研发项目	490,000.00	355,003.35
1.1	后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）	60,000.00	40,029.17
1.2	微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）	35,000.00	-
1.3	40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目	150,000.00	107,603.19
1.4	28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目	245,000.00	207,370.98
2	收购制造基地厂房及厂务设施	310,000.00	276,393.67
3	补充流动资金及偿还贷款	150,000.00	151,727.42
合计		950,000.00	783,124.44

注：截至 2024 年 6 月 30 日，募投项目“收购制造基地厂房及厂务设施”、“补充流动资金及偿还贷款”已结项，具体内容详见《晶集成 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

三、本次终止、变更募投项目的具体情况

公司根据募投项目实际实施的情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）”，并将该项目拟投入募集资金 35,595.58 万元（含现金管理收益及利息收入）变更投向至其他募投项目“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”。“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”投资总额由 245,000.00 万元增加至 280,595.58 万元，其中投资额增加部分为“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）”的结余资金。除此以外，“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”的实施主体、实施方式及实施地点均未发生变化。具体情况如下：

单位：万元

本次调整前		拟变更募集资金金额	调整事项	本次调整后	
项目名称	原募集资金拟投资金额			投资总额	募集资金拟投资金额

微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）	35,000.00	35,595.58	终止变更投向	-	-
28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目	245,000.00	35,595.58	调整投资总额及募集资金拟投资金额	280,595.58	280,595.58

注：1、上述数据为截至2024年12月23日的的数据，拟变更募集资金金额未包含尚未收到的现金管理收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准。

2、由于募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”目前所在银行账户涉及项目外其他募集资金存储，公司仍将保留该募集资金专户，继续用于其余募集资金存储及使用。股东会审议通过后，公司将拟变更募集资金金额转入新开立的募集资金专户，确保本次转入的募集资金做到专款专用。

四、本次变更事项的主要原因

受主轴产品研发策略和市场需求变化的影响，公司从市场需求、技术投入、投资收益以及成本控制等多个维度重新对募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”进行评估，认为该项目效益相较于最初预期出现了明显的降低趋势。公司决定整合研发资源并聚焦于公司主力产品，将更多研发力量投向效益更好的研发项目。

28纳米逻辑及OLED芯片在市场上展现出巨大的需求潜力，并且公司“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”的开发进展顺利，目前已取得了良好的阶段性成果，28nm逻辑芯片通过功能性验证，28nm OLED驱动芯片预计将于2025年上半年批量量产。公司期望通过扩大投资额，加快推动28nm产品的工艺精进及效能提升，以满足客户日益增长且不断变化的需求。

鉴于上述情况，公司经慎重考虑决定终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”，并将该项目募集资金变更投向至其他募投项目“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”，增加“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”的投资总额。本次变更募投项目有利于更快实现效益，拓展产品的应用领域，使公司在激烈的市场竞争中占据更有利的地位，符合公司实际经营需要，具有合理性和必要性。

五、本次变更事项对公司的影响

本次终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目是公司根据市场变化和实

际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置。本次变更不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响。本次变更事项契合公司未来业务拓展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次募投项目延期的审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

2024年12月30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，董事会同意本次终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目事项，并授权公司管理层及其授权人士在股东会审议通过本次事项后办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。该事项尚需提交公司股东会审议。

（二）监事会意见

公司本次终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目事项是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。该事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》。

七、保荐机构的核查意见

公司本次终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行程序完备、合规，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，不影响其他募集资金投资项目的实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。综上，保荐机构对公

司本次终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



周 玉



李义刚

中国国际金融股份有限公司



2024年12月31日